

TIF®070-11 是一款柔软的硅凝胶型的间隙填充材料，采用特殊配方与填料混合制成，兼具优异的导热性能与柔软特性。与一般导热硅油相比，TIF®070-11 具备更高的黏度，可有效防止填料与硅胶基材的分离，并抑制填料迁移，有助于稳定控制热传导效率。其施作方式与导热膏类似，适用于商用点胶或自动化设备操作。典型应用包含倒装芯片微处理器、PPGA、微型 BGA 封装、BGA 封装、DSP 晶片、圆形加硅晶片、LED 照明及其他高功率电子元件。

特性

- 》良好的热传导率：**7.0 W/mK**
- 》柔软 与器件之间几乎无压力
- 》低热阻抗
- 》可轻松用于点胶系统自动化操作
- 》长期可靠性

应用

- 》散热器底部或框架
- 》LED液晶显示屏背光管、LED灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》微型热管散热器
- 》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件
- 》半导体自动试验设备

TIF® 070-11 系列特性表		
产品特性	典型值	测试标准
颜色	灰色	目视
结构&成份	陶瓷填充硅材料	-
挤出量 (g/min)	30	兆科测试 (30 cc针筒/ 管口直径 2.5 mm/ 90 psi)
密度 (g/cc)	3.50	ASTM D297
导热系数 (W/mK)	7.0	ASTM D5470
热阻抗 @10psi (°C·in ² /W)	0.142	ASTM D5470
热阻抗 @50psi (°C·in ² /W)	0.120	ASTM D5470
建议使用温度范围 (°C)	-45~200	兆科测试
介电强度 (V/mm)	≥4000	ASTM D149
最小界面厚度 (mm)	0.20	兆科测试
阻燃等级	V-0	UL94
保质期限	12个月	-

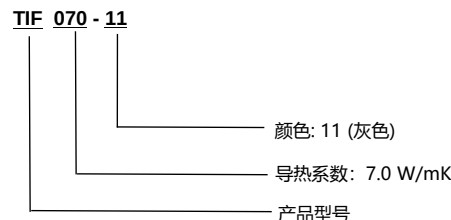
产品规格:

•30 cc/支, 98 支/箱; 300 cc/支, 6 支/箱, 或用于自动化应用的定制包装。

如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网。

产品型号说明:



全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com
 www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性，可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。



TIF070-11-0625